



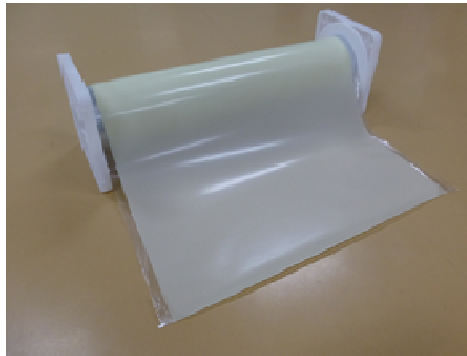
「SEMICON Japan」 出展のお知らせ

 三菱ガス化学株式会社

2014年11月26日

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：倉井敏磨）は、「SEMICON Japan」に半導体プリント配線基板に用いられる BT 樹脂ベースの絶縁フィルム材料「FRS-381SP」を出展致します。

本製品は、セミアディティブ対応の絶縁材料です。高絶縁信頼性、高耐熱性を有し、また、ガラスクロスレスであることから、従来に無い薄い絶縁層への対応が可能です。



フィルムタイプ絶縁材料：FRS-381SP

ご来場の際には、是非当社ブースにお立ち寄りください。

SEMICON Japan

会期：2014年12月3日（水）～5日（金）

場所：東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟（1254番ブース）

WEB サイト：<http://www.semiconjapan.org/ja/>

<本件に関するお問い合わせ先>

広報IR部 TEL：03-3283-5041